

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E04C 1/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820090048.6

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201214845Y

[22] 申请日 2008.5.26

[21] 申请号 200820090048.6

[73] 专利权人 董宝柱

地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区极乐
四道街 11 栋 541 室

[72] 发明人 董宝柱 张连军

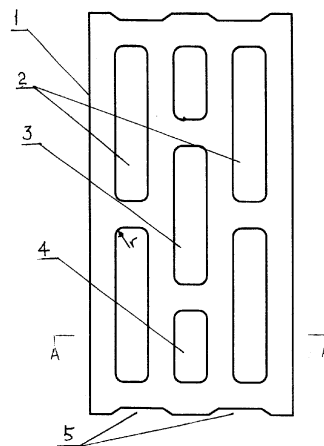
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

空心建筑砌块

[57] 摘要

本实用新型涉及一种空心建筑砌块，在砌块体内设有两排对称相同的第一长形封底孔，对称第一长形封底孔之间中央部位有一个与第一长形封底孔相同的第二长形封底孔，其上下两端有对称的封底孔。本实用新型结构简单、设计合理，成本低廉、易加工、重量轻，采用本砌块体在建筑墙体砌筑中完全能达到壁对壁、孔对孔，使建筑的墙体承重强度不会降低，受力均匀、保证建筑质量，尤其是适用于多层建筑，本实用新型具有抗拆力强，可使用本砌块直接砌筑。



1. 一种空心建筑砌块，包括砌块体，其特征在于：在砌块体（1）内设有两排对称相同的第一长形封底孔（2），对称第一长形封底孔（2）之间中央部位有一个与第一长形封底孔（2）相同的第二长形封底孔（3），其上下两端有对称的封底孔（4）。
2. 根据权利要求1所述的空心建筑砌块，其特征在于：第一长形封底孔（2）、第二长形封底孔（3）、封底孔（4）之间的间距均为 30mm。
3. 根据权利要求1所述的空心建筑砌块，其特征在于：砌块体（1）内的第一长形封底孔（2）、第二长形封底孔（3）均圆角，其圆角的半径 r 为 20mm。
4. 根据权利要求1所述的空心建筑砌块，其特征在于：砌块体（1）两侧分别有对称凹槽（5）。

空心建筑砌块

技术领域

本实用新型涉及墙体建筑材料，尤其是涉及一种带封底孔的建筑砌块。

背景技术

目前，用于建筑的砌块已有多种，通常是在砌块体内有二排或三排通孔，这种砌块体易加工、成本低廉，但是存在着冷桥现象，同时还存在墙体承重强度较差。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述技术中存在的不足之处，提供一种结构简单、设计合理，保温效果好，墙体承重强度高的空心建筑砌块。

为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：在砌块体内设有两排对称相同的第一长形封底孔，对称第一长形封底孔之间中央部位有一个与第一长形封底孔相同的第二长形封底孔，其上下两端有对称的封底孔。

本实用新型的优点是：

- (1) 结构简单、设计合理，成本低廉、易加工、重量轻；
- (2) 采用本砌块体在建筑墙体砌筑中完全能达到壁对壁、孔对孔，使建筑的墙体承重强度不会降低，受力均匀、保证建筑质量，尤其是适用于多层建筑；
- (3) 本实用新型具有抗拆力强，可使用本砌块直接砌筑。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图；

图2是图1的A—A剖视图；

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细描述。

由图1—图2可知，本实用新型在砌块体1内设有两排对称相同的第一长形封底孔2，对称第一长形封底孔2之间中央部位有一个与第一长形

封底孔 2 相同的第二长形封底孔 3，其上下两端有对称的封底孔 4。

第一长形封底孔 2、第二长形封底孔 3、封底孔 4 之间的间距均为 30mm。

砌块体 1 内的第一长形封底孔 2、第二长形封底孔 3 均圆角，其圆角的半径为 20mm。

砌块体 1 两侧分别有对称凹槽 5。

本砌块体在建筑墙体砌筑中完全能达到壁对壁、孔对孔，使建筑的墙体承重强度不会降低，受力均匀、保证建筑质量，尤其是适用于多层建筑，本实用新型砌块体内有三排封底孔，其间距是相等，均为 30mm，行间距也为 30mm，砌块体内的第一长形封底孔、第二长形封底孔、封底孔均为圆角，圆角半径 r 为 20mm。

由于本实用新型壁对壁、孔对孔，有效改善了砌筑时的砂浆饱满度和墙体整体性，提高了成型性能和物理性能，适用于在各类建筑物上作为承重或非承重墙体材料。

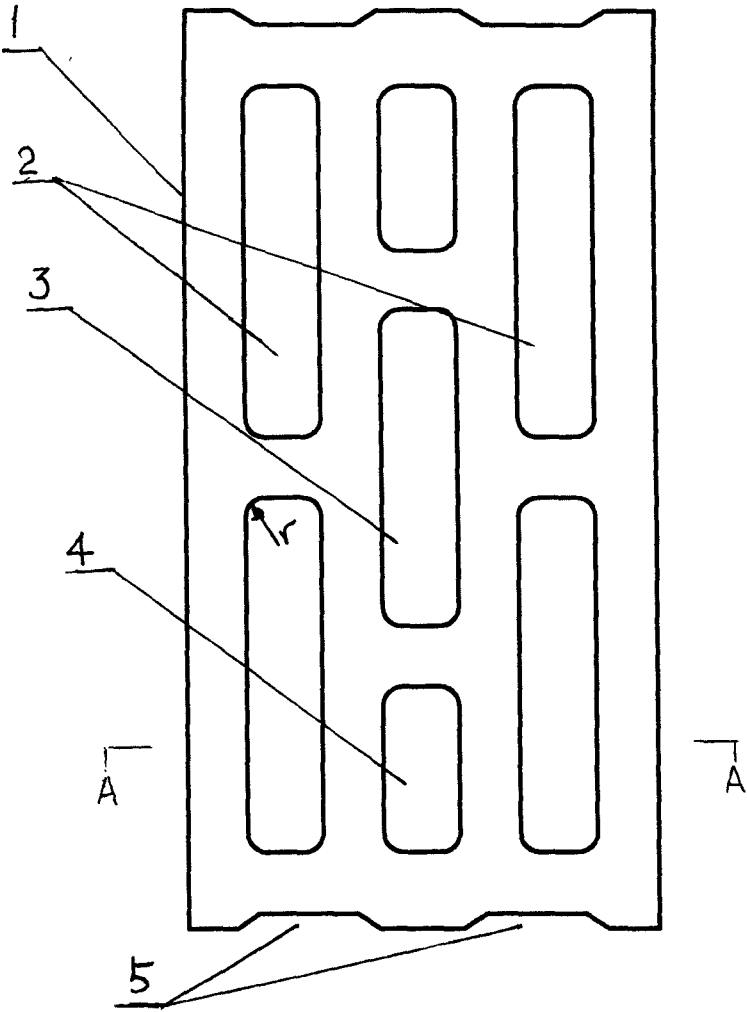


图 1

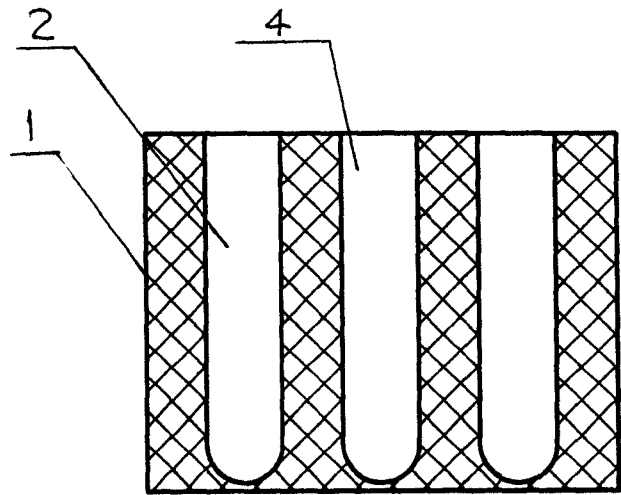


图 2